

Quad Flat Pack

QFP

- Obudowy do montażu powierzchniowego, o dużej gęstości wyprowadzeń rozmieszczonych po czterech stronach obudowy.
- Występujące wariacje: CQFP (ceramiczny materiał obudowy), MQFP (miedziana obudowa), TQFP (obudowa nie grubsza niż 2mm), VQFP (very small QFP).

Podstawowe parametry:

- liczba pinów: 32- 304
- odstęp między pinami [mm]: 0.4, 0.5, 0.635, 0.65, 0.8, 1
- rozmiar obudowy: od 7 do 40 mm
- kształt obudowy: prostokątny lub kwadratowy



QFP - wygląd

